**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **南昌红外光电科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **19.01.01** |
| **教师姓名** | | **蒋振华** | | **专业** | **19.01.01** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **19.01.01** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **固晶―烧结―焊线―封装―一切―镀锡（适用时）―二切―条带测试―三切―自动测试―边带―检验―包装** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | **市场需求的变化 ：遥控器向蓝牙方面发展，出现替代产品**  **措施：开发新市场**  **成本增加：主材价格上涨**  **措施：关注市场变化形势，储备主材**  **人员：人员老龄化，新员工培训需要一定时间**  **措施：储备一定人员**  **设备：设备老化，存在设备故障风险**  **措施：增加设备检查间隔，更换老化部件** | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **不涉及** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不涉及** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **SJ/T 11394-2009半导体发光二极管测试方法SJ/T 11577-2016SJ/T 11394-2009《半导体发光二极管测试方法》应用指南、DB35/T 1193-2011半导体发光二极管芯片SJ/T 2658.1-16-2015半导体红外发射二极管测量方法等、客户提供样品、客户要求** | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **提供检验报告** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | |

**填表人(专业人员)：蒋振华 审核组长：朱晓丽 日期：2021.5.25**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**